

## Internationalisierung von Spitzenclustern: Cluster Leistungselektronik koordiniert Projekte zur Zusammenarbeit mit Japan

21.11.2018 | Internationalisierung Deutschlands, Bi-/Multilaterales

Im Rahmen der Fördermaßnahme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur Internationalisierung von Spitzenclustern, Zukunftsprojekten und vergleichbaren Netzwerken koordiniert das ECPE - Cluster Leistungselektronik zwei Verbundprojekte mit Partnern aus Japan.

In einer zweijährigen Konzeptionsphase hat das Cluster Leistungselektronik im ECPE e. V. mit Sitz in Nürnberg gemeinsam mit ausgewählten Clusterakteuren ein Internationalisierungskonzept für eine Forschungsk Kooperation mit Japan ausgearbeitet. Dabei geht es um neuartige Leistungshalbleiter mit großem Bandabstand (Siliciumcarbid, SiC und Galliumnitrid, GaN) und deren Systemintegration. In der inzwischen eingeleiteten Umsetzungsphase der Cluster-Internationalisierung wurden zwei BMBF-Verbundvorhaben, IsoGap und SiC-DCBreaker, mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer Fördersumme von insgesamt drei Millionen Euro gestartet.

Im IsoGap-Projekt geht es um Hochtemperaturmaterialien und Zuverlässigkeitstests für die neue Generation der „Wide Bandgap“ - Leistungselektronik. Ein deutsches Konsortium aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und dem Cluster Leistungselektronik im ECPE e. V. kooperiert dabei mit einem Industriekonsortium um die Universität Osaka in Japan, das Materialunternehmen für die Hochtemperatur-Aufbau- und Verbindungstechnik umfasst.

Im Projekt „SiC-DCBreaker“ geht es um elektronische Trennschalter für Gleichstromnetze basierend auf SiC-Technologie. In dem Projekt arbeiten deutsche Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie der Cluster Leistungselektronik im ECPE e.V. mit japanischen Universitäts- und Industriepartnern aus dem NPERC-J-Konsortium (New Generation Power Electronics & System Research Consortium Japan) zusammen.

Die deutschen Teilkonsortien werden im Rahmen der Fördermaßnahme des BMBF zur Internationalisierung von Spitzenclustern gefördert.

Quelle: Clusterplattform Deutschland

Redaktion: 21.11.2018 von Tim Mörsch, VDI Technologiezentrum GmbH

Länder / Organisationen: Japan

Themen: Engineering und Produktion

[Zurück](#)

---

## Weitere Informationen